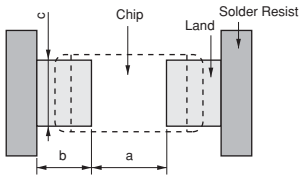
実装情報

■標準ランド寸法図



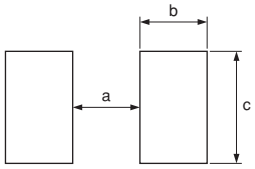
(in mm)

Part Number	Mounting Methods	Dimensions (mm)			
		Chip (L×W)	a	b	c
NCG18	Conductive Glue	1.6×0.8	0.6	0.6	1.0

■使用上の注意（実装上の注意）

素子破壊や特性劣化の恐れがあり、また実装不良の原因ともなりえますので、基板への取付けに際して次の事項に注意してください。

1. 標準ランド寸法
   寸法aを小さく設計すると、実装時に導電性接着剤が延び、短絡する恐れがあるためご注意ください。

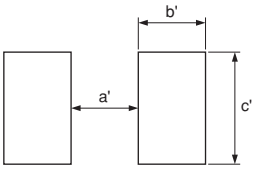


	a	b	c
ランドサイズ	0.6	0.6	1.0

(in mm)

2. 標準導電性接着剤
   PC3000 (Heraeus社製)

3. 導電性接着剤印刷マスク
   (1) 標準マスクサイズ



	a'	b'	c'
ランドサイズ	0.65	0.55	0.95

(in mm)

   (2) 標準の印刷マスク厚みは50μmです。

   (3) 導電性接着剤の塗布厚みを厚くすると、実装時に導電性接着剤が延び、短絡する恐れがあるためご注意ください。

4. 実装における諸条件によっては、予測できない実装状態が発生する恐れがありますので、貴社実装条件下での実装状態の評価を必ず行ってください。